

Errata

TMS320F280013x Real-Time MCUs Silicon Errata**シリコン リビジョン C、B、A、0**

概要

この文書では、機能仕様に対する既知の例外 (アドバイザリ) について説明します。本文書には、使用上の注意事項も記載されています。使用上の注意は、デバイスの動作が推定または文書化された動作と一致しない可能性がある状況を示しています。これには、デバイスの性能や機能の正確さに影響を与える動作が含まれる場合があります。

目次

1 使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス.....	3
1.1 使用上の注意マトリックス.....	3
1.2 アドバイザリ マトリックス.....	3
2 命名法、パッケージのマーキングとリビジョンの識別.....	4
2.1 デバイスおよび開発ツールの命名規則.....	4
2.2 サポート対象デバイス.....	4
2.3 パッケージの記号表記およびリビジョンの識別.....	5
3 シリコン リビジョン C の使用上の注意とアドバイザリ.....	7
3.1 シリコン リビジョン C の使用上の注記.....	7
3.2 シリコン リビジョン C のアドバイザリ.....	9
4 シリコン リビジョン B の使用上の注意とアドバイザリ.....	30
4.1 シリコン リビジョン B の使用上の注記.....	30
4.2 シリコン リビジョン B のアドバイザリ.....	30
5 シリコン リビジョン A の使用上の注意とアドバイザリ.....	31
5.1 シリコン リビジョン A の使用上の注記.....	31
5.2 シリコン リビジョン A のアドバイザリ.....	31
6 シリコン リビジョン 0 の使用上の注意とアドバイザリ.....	32
6.1 シリコン リビジョン 0 の使用上の注記.....	32
6.2 シリコン リビジョン 0 のアドバイザリ.....	32
7 ドキュメントのサポート.....	33
8 商標.....	33
9 改訂履歴.....	33

図の一覧

図 2-1. PM パッケージのパッケージ マーキング.....	5
図 2-2. PT パッケージのパッケージ マーキング.....	5
図 2-3. RGZ パッケージのパッケージ マーキング.....	5
図 2-4. RHB パッケージのパッケージ マーキング.....	6
図 3-1. AGPIO と AIO アナログ ピン タイプを含むアナログ サブシステム図.....	13
図 3-2. 望ましくないトリップ イベントとブランキング ウィンドウの期限切れ.....	16
図 3-3. 結果として望ましくない ePWM 出力が発生する可能性があります.....	16
図 3-4. パイプラインにストールがない場合の問題のパイプライン図.....	19
図 3-5. 命令 I1 の E3 スロットにストールがある場合の問題のパイプライン図.....	20
図 3-6. 回避方法が適用されたパイプライン図.....	21

表の一覧

表 1-1. 使用上の注意マトリックス.....	3
表 1-2. アドバイザリ マトリックス.....	3

表 2-1. リビジョンの識別.....	6
表 3-1. ADCCTL2 レジスタ.....	10
表 3-2. 特定のアナログ入力ピンの使用事例の組み合わせ.....	13
表 3-3. 標準モードホストを備えたターゲットトランスミッタとしての C2000 のデータ立ち上がり時間要件.....	23
表 3-4. 一般的なバス容量 (C_b) のプルアップ抵抗 (R_p) 値.....	24
表 3-5. アドバイザリによって影響を受けるメモリ.....	25
表 3-6. OTP リビジョン番号の位置.....	26

1 使用上の注意およびアドバイザーリ マトリックス

表 1-1 に、すべての使用上の注意と、該当するシリコンのリビジョンを示します。表 1-2 にすべてのアドバイザーリ、影響を受けるモジュール、および適用可能なシリコン リビジョンを一覧表示します。

1.1 使用上の注意マトリックス

表 1-1. 使用上の注意マトリックス

番号	タイトル	影響を受けるシリコンのリビジョン			
		0	A	B	C
セクション 3.1.1	PIE: 双方向 PIEACK 書き込みと手動 CPU 割り込みマスク クリア後のスプリアス ネスト割り込み	あり	あり	あり	あり
セクション 3.1.2	繰り返しブロックでネストされた割り込みを使用する際の注意	あり	あり	あり	あり
セクション 3.1.3	セキュリティ: プライマリ防御層はチップの境界を保護します。これは、JTAGLOCK およびフラッシュからのゼロ ピン ブート機能を有効化することから始まります	あり	あり	あり	あり

1.2 アドバイザリ マトリックス

表 1-2. アドバイザリ マトリックス

モジュール	説明	影響を受けるシリコンのリビジョン			
		0	A	B	C
ADC	ADC: INTxCONT (割り込み継続モード) が設定されていない場合、割り込みは停止する可能性があります	あり	あり	あり	あり
ADC	ADC: ADCCLK 分周器により ADC の性能が低下	あり	あり	あり	あり
BOR	BOR: 2.45V ~ 3.0V の VDDIO は、複数の XRSn パルスを生成する可能性があります	あり	あり	あり	あり
CMPSS	CMPSS: COMPxLATCH は、特定の条件では正しくクリアされないことがあります	あり	あり	あり	あり
CMPSS	CMPSS: コンパレータ入力ピンに AGPIO 機能があり、ADC が入力ピンをサンプリングしている場合、CMPSS グリッチが発生する可能性があります	あり	あり	あり	あり
DCAN	DCAN FIFO モードでは、受信したメッセージは FIFO バッファの順序に従わず配置できます	あり	あり	あり	あり
ePWM	ePWM: ePWM グリッチは、ブランキング ウィンドウの終了時にトリップがアクティブのままの場合、発生する可能性があります	あり	あり	あり	あり
ePWM	ePWM: ブランキング ウィンドウ開始後の最初の 3 サイクルの間、トリップ イベントはブランキング ウィンドウによってフィルタされません	あり	あり	あり	あり
eQEP	eQEP: インデックス中の方向変更時に位置カウンタが正しくリセットされません	あり	あり	あり	あり
フラッシュ	フラッシュ: シングル ビット ECC エラー割り込みは生成されません	あり	あり	あり	あり
フラッシュ	フラッシュ API: 量産バージョンは、C2000Ware 4.03.00.00 では利用できません	あり	あり	あり	あり
FPU	FPU: FPU-to-CPU レジスタ移動操作の前にする FPU 2p 操作	あり	あり	あり	あり
GPIO	GPIO19/X1: 推奨動作条件の範囲外で電圧を印加すると、デバイスの誤動作が発生する可能性があります	あり	あり	あり	あり
I2C	I2C: ターゲットトランスミッタ モード、標準モードの SDA タイミングの制限	あり	あり	あり	あり
メモリ	メモリ: 有効なメモリを超えたプリフェッチ	あり	あり	あり	あり
MPOST	MPOST: 一部の初期素材ではメモリ パワーオン セルフテストが実行されません	あり	あり	あり	あり
システム	システム: CLKSRCCTL1 への複数の連続した書き込みを行うと、システムがハングする可能性があります	あり	あり	あり	あり
PLL	PLL リファレンス クロック消失検出: クロック消失フラグが正しくアクティブ化されない可能性があります	あり	あり	あり	あり
ウォッチドッグ	ウォッチドッグ: WDKEY レジスタは EALLOW 保護されていません	あり	あり	あり	あり

2 命名法、パッケージのマーキングとリビジョンの識別

2.1 デバイスおよび開発ツールの命名規則

製品開発サイクルの段階を示すために、TI では DSP デバイスとサポートツールすべての型番に接頭辞を割り当てます。DSP 商用ファミリの製品には、次の 3 つの接頭辞のいずれかが付いています。TMX、TMP、TMS (たとえば、TMS320F2800137)。テキサス・インスツルメンツでは、サポートツールについては、使用可能な 3 つの接頭辞のうち TMDX および TMDS の 2 つを推奨しています。これらの接頭辞は、製品開発の進展段階を表します。段階には、エンジニアリング プロトタイプ (TMX および TMDX) から、完全認定済みの量産デバイス/ツール (TMS および TMDS) まであります。

デバイスの開発進展フロー:

TMX 実験的デバイス。最終デバイスの電気的特性を必ずしも表さず、量産アセンブリ・フローを使用しない可能性があります。

TMP プロトタイプ・デバイス。最終的なシリコン・ダイとは限らず、最終的な電気的特性を満たさない可能性があります。

TMS 認定済みのシリコン・ダイの量産バージョン。

サポート・ツールの開発進展フロー:

TMDX 開発サポート製品。テキサス・インスツルメンツの社内認定試験はまだ完了していません。

TMDS 完全に認定済みの開発サポート製品です。

TMX および TMP デバイスと TMDX 開発サポート・ツールは、以下の免責事項の下で出荷されます。

「開発中の製品は、社内での評価用です」。

量産デバイスおよび TMDS 開発サポート・ツールの特性は完全に明確化されており、デバイスの品質と信頼性が十分に示されています。テキサス・インスツルメンツの標準保証が適用されます。

プロトタイプ・デバイス (X または P) の方が標準的な量産デバイスに比べて故障率が大きいと予測されます。これらのデバイスは予測される最終使用時の故障率が未定義であるため、テキサス・インスツルメンツでは、それらのデバイスを量産システムで使用しないよう推奨しています。認定済みの量産デバイスのみを使用する必要があります。

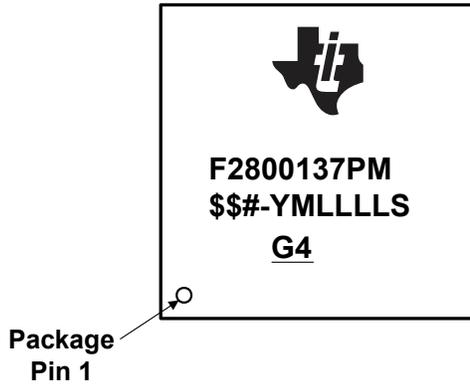
2.2 サポート対象デバイス

本文書は、以下のデバイスをサポートしています。

- [TMS320F2800137](#)
- [TMS320F2800135](#)
- [TMS320F2800133](#)
- [TMS320F2800132](#)

2.3 パッケージの記号表記およびリビジョンの識別

パッケージ マーキングを 図 2-1、図 2-2、図 2-3、および 図 2-4 に示します。表 2-1 に、シリコンのリビジョン コードを示します。

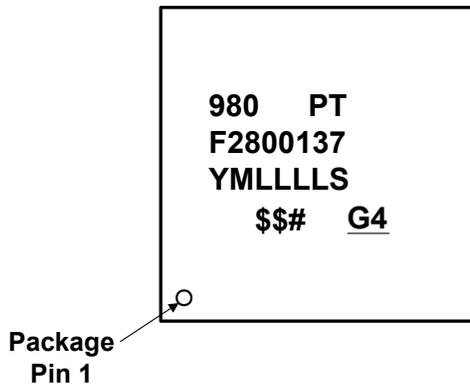


YMLLLLLS = Lot Trace Code

YM = 2-digit Year/Month Code
LLLL = Assembly Lot Code
S = Assembly Site Code
\$\$ = Wafer Fab Code (one or two characters) as applicable
= Silicon Revision Code

G4 = Green (Low Halogen and RoHS-compliant)

図 2-1. PM パッケージのパッケージ マーキング

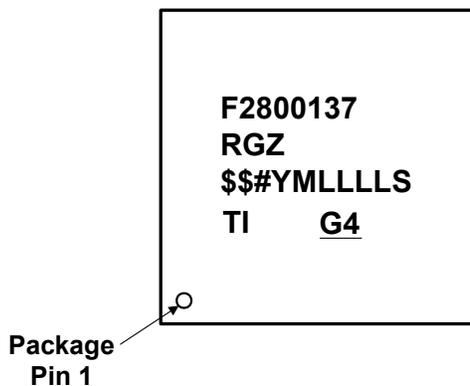


YMLLLLLS = Lot Trace Code

980 = TI EIA Code
YM = 2-digit Year/Month Code
LLLL = Assembly Lot Code
S = Assembly Site Code
\$\$ = Wafer Fab Code (one or two characters) as applicable
= Silicon Revision Code

G4 = Green (Low Halogen and RoHS-compliant)

図 2-2. PT パッケージのパッケージ マーキング



YMLLLLLS = Lot Trace Code

YM = 2-digit Year/Month Code
LLLL = Assembly Lot Code
S = Assembly Site Code
\$\$ = Wafer Fab Code (one or two characters) as applicable
= Silicon Revision Code

G4 = Green (Low Halogen and RoHS-compliant)

図 2-3. RGZ パッケージのパッケージ マーキング

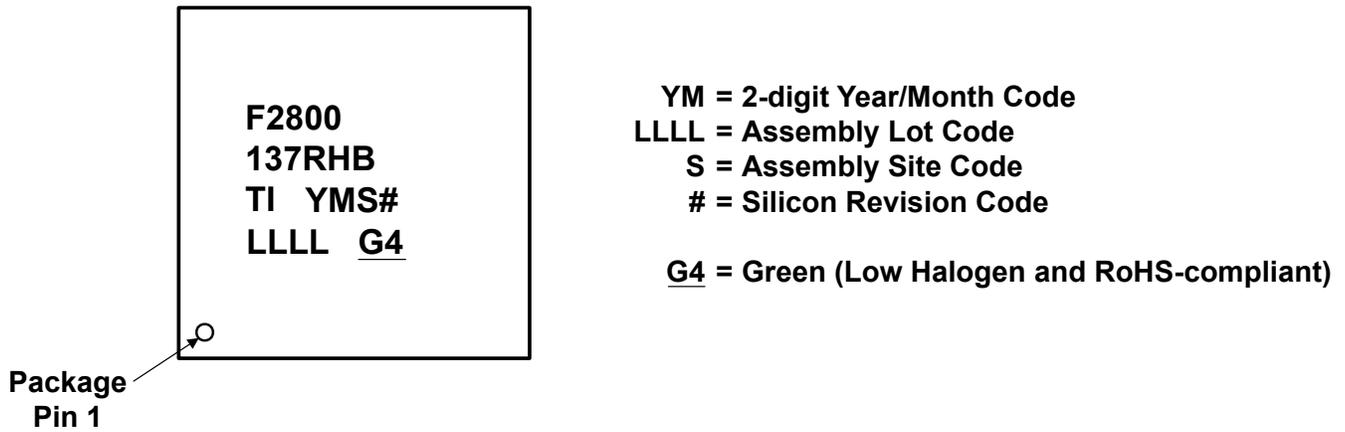


図 2-4. RHB パッケージのパッケージ マーキング

表 2-1. リビジョンの識別

シリコンのリビジョンコード	シリコンのリビジョン	REVID ⁽¹⁾ アドレス:0x5D00C	備考 ⁽²⁾
空白	0	0x0000 0001	このシリコン リビジョンは TMX として供給されま す。
A	A	0x0000 0002	このシリコン リビジョンは TMX として供給されま す。
B	B	0x0000 0003	このシリコン リビジョンは TMS として供給されま す。リビジョン B と C は機能的に同等です。
C	C	0x0000 0004	このシリコン リビジョンは TMS として供給されま す。リビジョン B と C は機能的に同等です。

- (1) シリコンのリビジョン ID
 (2) 注文可能なデバイス番号については、[TMS320F280013x リアルタイム マイクロコントローラのデータシートのパッケージ情報表](#)を参照してください。

3 シリコン リビジョン C の使用上の注意とアドバイザリ

このセクションには、このシリコン リビジョンの使用上の注意およびアドバイザリが記載されています。

3.1 シリコン リビジョン C の使用上の注記

このセクションでは、シリコン リビジョン C およびそれ以前のシリコン リビジョンに適用されるすべての使用上の注意を一覧表示しています。

3.1.1 PIE: 双方向 PIEACK 書き込みと手動 CPU 割り込みマスク クリア後のスプリアス ネスト割り込み

影響を受けるリビジョン: 0、A、B、C

ネストされた割り込みに使用される特定のコード・シーケンスでは、CPU と PIE が矛盾した状態に移行し、望ましくない割り込みをトリガできるようになります。この状態に入るために必要な条件は次のとおりです。

1. PIEACK クリアの後に、グローバル割り込み友好状態 (EINT または ASM (「CLRC INTM」)) が直ちに続きます。
2. ネストされた割り込みにより、そのグループの一つ以上の PIEIER ビットがクリアされます。

不要な割り込みがトリガされるかどうかは、システム内の他の割り込みの構成とタイミングによって異なります。これは、ほとんどのアプリケーションではまれなイベントまたは存在しないイベントであると予想されます。発生した場合、不要な割り込みはネストされた割り込みの PIE グループの最初の割り込みになり、ネストされた割り込みが CPU 割り込みを再度イネーブルにした後にトリガされます (EINT または ASM (「CLRC INTM」))。

回避方法: PIEACK 書き込みと CPU 割り込み有効化の間に NOP を追加します。コード例を以下に示します。

```
//Bad interrupt nesting code
PieCtrlRegs.PIEACK.all = 0xFFFF;    //Enable nesting in the PIE
EINT;                                  //Enable nesting in the CPU

//Good interrupt nesting code
PieCtrlRegs.PIEACK.all = 0xFFFF;    //Enable nesting in the PIE
asm(" NOP");                          //wait for PIEACK to exit the pipeline
EINT;                                  //Enable nesting in the CPU
```

3.1.2 繰り返しブロックでネストされた割り込みを使用する際の注意

影響を受けるリビジョン: 0、A、B、C

ネスト機能を使用するために、ユーザーが割り込みサービス ルーチン (ISR) 内で EINT 命令を使用して割り込みを有効にしている場合、ユーザーは ISR を終了する前に DINT アセンブリ命令を使用して割り込みを無効にする必要があります。この操作を怠ると、RB レジスタのビットが正しく復元されず、コードが未定義の動作が発生する可能性があります。

RPTB ASM 命令がアプリケーション内で使用されていない場合、問題はありません。C 言語でコーディングしている場合、生成された逆アセンブリの解析を実行して、これを確認する必要があります。

ISR を C 言語でコーディングしている場合は、C28x C コンパイラが上記の処理をすることがあり、何もする必要はありません。ISR が C28x アセンブリ言語でコーディングされている場合、上記のガイダンスに従う必要があります。

注

2016 年 4 月以降の CGT パッケージでリリースされた CGT v15.12.2.LTS は、この要件に自動的に対応します。DINT は、CGT ツールの以前のバージョンでのみ追加する必要があります。

3.1.3 セキュリティ: プライマリ防御層はチップの境界を保護します。これは、JTAGLOCK およびフラッシュからのゼロピンブート機能を有効化することから始まります

影響を受けるリビジョン: 0、A、B、C

デバイスのセキュリティは、不正なコードがデバイスに侵入して実行されることを許可されていないという前提に依存しています。そのため、セキュリティを懸念するユーザーが常に有効にする必要のある 2 つの機能をデバイスに搭載していません。

• JTAGLOCK

フラッシュの USER OTP 領域で有効にすると、JTAGLOCK 機能はデバイス上のリソースへの JTAG アクセス (デバッグ接続など) を無効にし、権限のない者が JTAG インターフェイスを使用してデバイスにコードをダウンロードすることをブロックします。JTAGLOCK が有効な場合でも、ユーザーは許可された当事者がパスワードを入力してロックを解除できるようにしたり、すべてゼロのパスワード値をプログラムして永続的にロックしたりすることができます。

• ゼロピンブートからフラッシュ

TI ROM に組み込まれた外部ブートローダは、ダウンロードされたコードの認証を実行しません。USER OTP でフラッシュブートモードとともにゼロピンブートオプションを有効にすると、ベースブート ROM の実行が終了した後、ブートプロセスが直ちに内部フラッシュにジャンプするように強制され、すべてのピンベースの外部ブートローダオプション (SCI、CAN、パラレルなど) がブート時に実行されなくなります。最高のセキュリティを実現するために、セキュアフラッシュブートモードを選択できます。これにより、ベースブート ROM にジャンプする前にフラッシュコードを事前にチェックできるようになります。

JTAG が永続的にロックされ、Zero-pin Boot to Flash (ゼロピンブートからフラッシュ) オプションが有効になっている場合、JTAG または内蔵ブートローダを介してデバイスと通信するプログラミングツールは動作しません。ファームウェアのアップグレードを実行する機能が必要な場合、更新を安全に管理および実行するため、コードをフラッシュに事前格納する必要があります。

3.2 シリコン リビジョン C のアドバイザリ

このセクションでは、シリコン リビジョン C およびそれ以前のシリコン リビジョン に適用されるすべてのアドバイザリを一覧表示しています。

アドバイザリ **ADC :INTxCONT (割り込み継続モード) が設定されていない場合、割り込みは停止する可能性があります**

影響を受けるリビジョン 0、A、B、C

詳細 ADCINTSELxNx[INTxCONT] = 0 の場合、ADCINTFLG が設定されると割り込みは停止し、追加の ADC 割り込みは発生しません。

ADCINTFLGCLR レジスタのソフトウェア書き込みとともに ADC 割り込みが同時に発生すると、ADCINTFLG が予期せず設定されたままになり、将来の ADC 割り込みをブロックします。

回避方法

1. ADCINTFLG が追加の ADC 割り込みをブロックしないように、Continue-to-Interrupt モードを使用します。

```

ADCINTSEL1N2[INT1CONT] = 1;
ADCINTSEL1N2[INT2CONT] = 1;
ADCINTSEL3N4[INT3CONT] = 1;
ADCINTSEL3N4[INT4CONT] = 1;
  
```

2. この状態を回避するために、次の ADC 割り込みが発生する前に、ADC ISR をサービスし、ADCINTFLG をクリアするのに十分な時間を常に確保してください。
3. ADCINTFLG をクリアするとき、ISR のオーバーフロー状態を確認します。ADCINTFLGCLR への書き込み直後に ADCINTOVF をチェックし、これが設定されている場合は、ADCINTFLGCLR をもう一度書き込んで ADCINTFLG がクリアされていることを確認します。ADCINTOVF レジスタが設定され、ADC 変換割り込みが失われたことを示します。

```

AdcaRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1;           //clear INT1 flag
if(1 == AdcaRegs.ADCINTOVF.bit.ADCINT1)         //ADCINT overflow
{
    AdcaRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1;       //clear INT1 again
    // If the ADCINTOVF condition will be ignored by the application
    // then clear the flag here by writing 1 to ADCINTOVFCLR.
    // If there is a ADCINTOVF handling routine, then either insert
    // that code and clear the ADCINTOVF flag here or do not clear
    // the ADCINTOVF here so the external routine will detect the
    // condition.
    // AdcaRegs.ADCINTOVFCLR.bit.ADCINT1 = 1;    // clear OVF
}
  
```

アドバイザリ
ADC:ADCCLK 分周器により ADC の性能が低下
影響を受けるリビジョン

0、A、B、C

詳細

分数 SYSCLK から ADCCLK への分周器 (ADCCTL2.PRESCALE フィールドで制御) を使用すると、このデバイスで ADC 性能が低下することが示されています。表 3-1 を参照してください。

表 3-1. ADCCTL2 レジスタ

性能が低下			
ビット	フィールド	値	説明
3-0	PRESCALE	0001	ADCCLK = SYSCLK/1.5
		0003	ADCCLK = SYSCLK/2.5
		...	
通常の性能			
ビット	フィールド	値	説明
3-0	PRESCALE	0000	ADCCLK = SYSCLK/1.0
		0002	ADCCLK = SYSCLK/2.0
		...	

回避方法

偶数 PRESCALE クロック分周器の値を使用します。偶数 PRESCALE 値では、整数クロック分周器が発生し、ADC の性能には影響しません。

アドバイザリ **BOR: 2.45V ~ 3.0V の VDDIO は、複数の XRSn パルスを生成する可能性があります**

影響を受けるリビジョン 0、A、B、C

詳細

VDDIO 電源電圧が 2.45V ~ 3.0V のとき、BOR は XRSn のアサートおよびディアサートを繰り返すことがあります。XRSn ピンをシステム内の他のデバイスのリセットとして直接使用しないことを推奨します。

F280013x BOR は、これらの XRSn パルスが発生した場合でも、デバイスを既知のリセット状態に内部で保持するのに有効です。デバイスはアプリケーション コードやブートローダに分岐せず、VDDIO 電源が 3.0V を上回るまで、他のすべてのピンはリセット状態に保持されます。

回避方法

1. パワーアップ、パワーダウン、BOR イベント中は、追加の XRSn 遷移は無視します。追加の XRSn パルスは、F280013x デバイスの動作自体には影響しません。
2. XRSn パルスによって他のシステム コンポーネントで望ましくないシステム動作が発生する場合は、XRSn を使用して他のデバイスを駆動しないでください。これらのアプリケーションには、外部電圧スーパーバイザを使用できます。
3. 通常のパワーアップおよびパワーダウン時にこれらのパルスを回避する必要があるアプリケーションでは、以下のように動作します。
 - a. パワーアップ: [TMS320F280013x リアルタイム マイクロ コントローラ](#) データ シートの「推奨動作条件」表の SR_{SUPPLY} 要件に従い、追加の XRSn Low パルスは発生しません。
 - b. パワーダウン: パワーダウン時に XRSn がアサートされるのを防ぐため、VDDIO が 25 μ s 内で 3.0V~2.45V の範囲を通過するように電源を設計してください。XRSn の電圧上昇が許容される場合、XRSn に実装された RC 回路の時間定数を計算し、その電圧がシステム指定のスレッシュホールドを超えないようにできます。

アドバイザリ **CMPSS:COMPxLATCH は、特定の条件では正しくクリアされないことがあります**
影響を受けるリビジョン 0、A、B、C

詳細

CMPSS ラッチ パスは、ソフトウェアによって (COMPSTSCLR を介して) または PWMSYNC によってクリアされるまで、ローカル ラッチ (COMPxLATCH) 内でトリップ状態を維持するように設計されています。

COMPxLATCH は、信号がデジタル化され、デジタル フィルタによって認定された後、コンパレータ出力によって間接的に設定されます。コンパレータ出力が COMPxLATCH に達することが期待される最大レイテンシは、CMPSS モジュール クロック サイクルでは次のように表されます。

$$\text{LATENCY} = 1 + (1 \times \text{FILTER_PRESCALE}) + (\text{FILTER_THRESH} \times \text{FILTER_PRESCALE})$$

ソフトウェアまたは PWMSYNC によって COMPxLATCH がクリアされると、ラッチ自体は必要に応じてクリアされますが、COMPxLATCH 前のデータ パスは、追加のレイテンシ数のモジュール クロック サイクルについて、コンパレータの出力値を反映していない可能性があります。

COMPxLATCH がクリアされたときにデジタル フィルタ出力が論理 1 に解決されると、次のクロック サイクルでラッチが再度セットされます。

回避方法

COMPxLATCH をクリアする前に、デジタル フィルタ出力を論理 0 に解決できます。

ソフトウェアによって COMPxLATCH がクリアされた場合、ラッチをクリアする前に、デジタル フィルタの出力状態を COMPSTS レジスタで確認できます。レイテンシ値が大きいと許容できない遅延が発生する場合、デジタル フィルタを再初期化することでフィルタ FIFO をフラッシュできます (CTRIPxFILCTL 経由)。

PWMSYNC によって COMPxLATCH がクリアされた場合、PWMSYNC が生成される前に少なくともレイテンシ サイクルにわたってコンパレータトリップ条件がクリアされるように、ユーザー アプリケーションを設計する必要があります。

アドバイザリ

CMPSS :コンパレータ入力ピンに **AGPIO** 機能があり、**ADC** が入力ピンをサンプリングしている場合、**CMPSS** グリッチが発生する可能性があります

影響を受けるリビジョン

0, A, B, C

詳細

表 3-2 に、注意する必要がある特定のアナログ入力ピンの使用事例の組み合わせを示します。このテーブルに示すように、**CMPSS** 入力、**ADC** サンプリング、**AGPIO** の組み合わせには注意するか、回避方法を使用する必要があります。

表 3-2. 特定のアナログ入力ピンの使用事例の組み合わせ

特定のアナログ ピンで使用される機能	使用部品				
CMPSS コンパレータ入力	あり	-	あり	-	あり
ADC サンプリング	あり	あり	-	あり	あり
AGPIO アナログ ピン タイプ	あり	あり	あり	-	-
AIO アナログ ピン タイプ	-	-	-	あり	あり
結果	回避方法が必要		特別な分析や回避方法は不要		

AGPIO アナログ ピン パスには、53Ω の追加の直列スイッチが含まれています。これにより、図 3-1 に示すように、ADC および **CMPSS** コンパレータと共有される低容量の絶縁型ノードが作成されます。ADC が (ADC サンプル / ホールド コンデンサに保存されている前の電圧に応じて) チャンネルをサンプリングするとき、このノードに外乱が生じ、それによって最大 50ns の誤 **CMPSS** 事象が発生する可能性があります。下の回避方法を実装することで、この潜在的な外乱に対応できます。

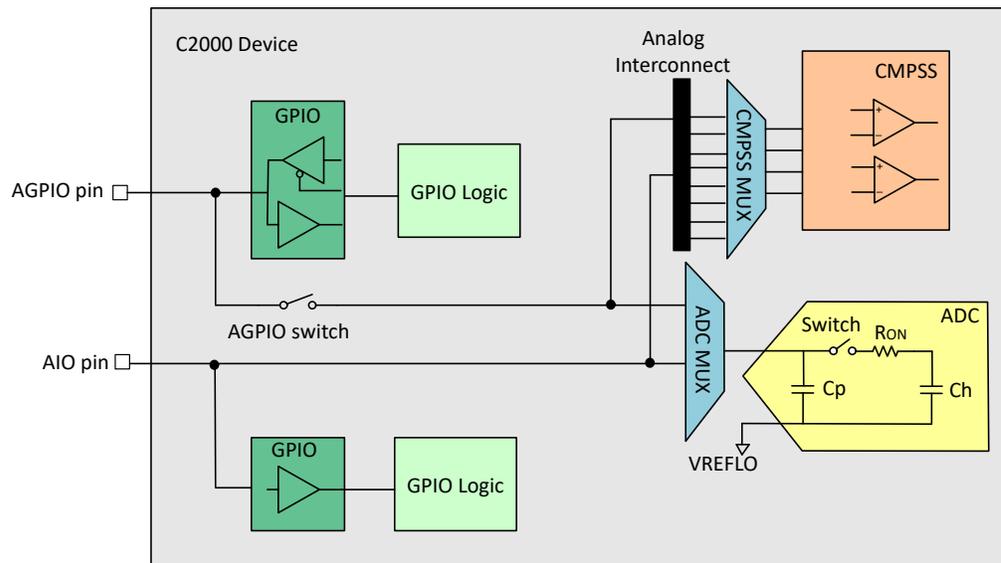


図 3-1. AGPIO と AIO アナログ ピン タイプを含むアナログ サブシステム図

回避方法

1. ADC と **CMPSS** の両方を同時に必要とするアナログ チャンネルには、別のピン (AIO ピン タイプ) を使用します。
2. **CMPSS** デジタル フィルタを 50ns 以上の設定で使用します。これにより、一時的な外乱がフィルタリングされます。
3. 外乱によって誤トリップが発生しないように、ADC の サンプル / ホールド コンデンサを事前に調整します。たとえば、影響を受けるチャンネルが読み取られる直前に、ADC の別のチャンネルから 3.3V 接続のダミー読み取りを実行します。これにより、外乱が正の方向になり、誤トリ

アドバイザリ (続き)

CMPSS : コンパレータ入力ピンに **AGPIO** 機能があり、**ADC** が入力ピンをサンプリングしている場合、**CMPSS** グリッチが発生する可能性があります

ップから離れます。誤トリップの極性が反転した場合、0V 信号の逆のダミー読み取りが使用されます。

アドバイザリ **DCAN FIFO モードでは、受信したメッセージは FIFO バッファの順序に従わず配置できません**

影響を受けるリビジョン 0、A、B、C

詳細

DCAN FIFO モードでは、同じアービトレーション ID とマスク ID を持つ受信メッセージは受信した順序で FIFO に配置されることになります。その後、CPU は IF1/IF2 インターフェイスレジスタを介して、FIFO から受信したメッセージを取得します。一部のメッセージは、受信した順序で FIFO に配置される場合があります。アプリケーションの処理にとってメッセージの順序が重要である場合、この動作により DCAN FIFO モードが適切に使用できなくなります。

回避方法

なし

アドバイザリ

ePWM : ePWM グリッチは、ブランキング ウィンドウの終了時にトリップがアクティブのままの場合、発生する可能性があります

影響を受けるリビジョン

0、A、B、C

詳細

ブランキング ウィンドウは通常、システムへの誤ったトリップを引き起こす可能性のある遷移中の PWM トリップ イベントをマスクするために使用されます。ブランキング ウィンドウ サイクルの終了後、3 未満の ePWM クロックの間 ePWM トリップ イベントがアクティブのまま維持されている場合、ePWM 出力に望ましくないグリッチが発生する可能性があります。

図 3-2 に、不要な EPWM 出力が発生する可能性のある時間を示します。

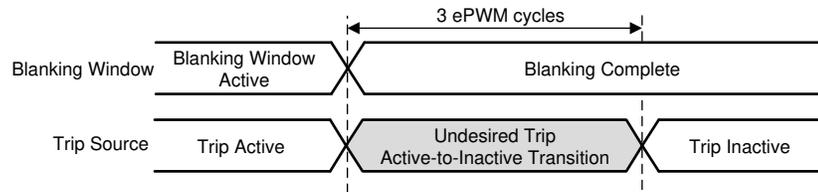


図 3-2. 望ましくないトリップ イベントとブランキング ウィンドウの期限切れ

図 3-3 に、ブランキング ウィンドウが閉じる前または 3 サイクル後にトリップ イベントが 1 サイクル以内に終了した場合に可能性のある 2 つの ePWM 出力を示します。

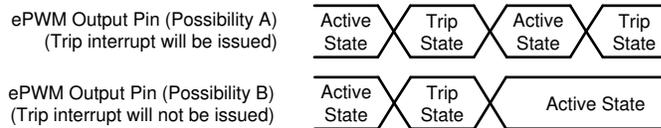


図 3-3. 結果として望ましくない ePWM 出力が発生する可能性があります

回避方法

ブランキング ウィンドウを延長または短縮して、不要なトリップ動作を回避します。

アドバイザリ

ePWM : ブランキング ウィンドウ開始後の最初の 3 サイクルの間、トリップ イベントはブランキング ウィンドウによってフィルタされません

影響を受けるリビジョン

0、A、B、C

詳細

ブランキング ウィンドウは、ブランキング ウィンドウの開始後の最初の 3 サイクルのトリップ イベントをブランクにしません。DCEVTFILT は、DCxEVTyp 信号の変更を継続的に反映することができます。DCEVTFILT が有効化されている場合、設定されている後続のサブシステム (たとえば、トリップゾーン サブモジュール、TZ 割り込み、ADC SOC、PWM 出力) に影響を及ぼす可能性があります。

回避方法

ブランキングが必要な前に、ブランキング ウィンドウを 3 サイクル開始します。周期境界でブランキング ウィンドウが必要な場合、次の周期の開始 3 サイクル前にブランキング ウィンドウを開始します。これは、ブランキング ウィンドウが期間の境界を越えて持続するため、機能します。

アドバイザリ

eQEP: インデックス中の方向変更時に位置カウンタが正しくリセットされません

影響を受けるリビジョン

0、A、B、C

詳細

PCRM = 0 構成を使用しているときに、インデックス入力がアクティブのときに方向変更が発生すると、位置カウンタ(QPOSCNT)が誤ってリセットされ、カウンタ値の予期しない変化が発生する可能性があります。その結果、位置カウンタの期待値から最大 ± 4 カウントが変化し、予期しないそれ以降のエラー フラグ設定が発生する可能性があります。

PCRM = 0 構成を使用しているとき、[つまり、インデックス イベント時の位置カウンタリセット (QEPCTL[PCRM] = 00)]、順方向移動中にインデックス イベントが発生した場合、位置カウンタは次の eQEP クロックで 0 にリセットされます。リバース移動中にインデックス イベントが発生すると、次の eQEP クロックの QPOSMAX レジスタの値に位置カウンタがリセットされます。eQEP ペリフェラルは、QEPSTS レジスタの最初のインデックス マーカー (QEPSTS[FIMF]) と最初のインデックス イベント マーカー (QEPSTS[FIDF]) の発生を記録します。また、インデックス イベントのリセット操作に同じ相対直交遷移が使用されるように、最初のインデックス マーカーの直交エッジを記憶します。

インデックス パルスがアクティブの間に方向変更が発生した場合、モジュールは引き続き相対的な直交遷移を探して、位置カウンタのリセットを実行します。これにより、位置カウンタ値が予期せず変化します。

同時に方向を変更せずに次のインデックス イベントが発生すると、カウンタが正しくリセットされ、期待どおりに動作します。

回避方法

インデックスがアクティブなときに方向が変更される可能性があり、結果として位置カウンタ値が変更されるとアプリケーションに影響を与える可能性がある場合は、PCRM=0 構成を使用しないでください。

アプリケーションに応じて位置カウンタのリセットを実行するその他のオプション (インデックス イベント初期化 (IEI) など) には、この問題はありません。

アドバイザリ フラッシュ: シングル ビット ECC エラー 割り込みは生成されません

影響を受けるリビジョン 0、A、B、C

詳細 シングル ビット ECC エラー スレッシュホールドが 0 に設定されている場合、シングル ビット エラーが発生しても、シングル ビット エラー 割り込みは生成されません。

回避方法 エラー スレッシュホールド ビット フィールド (FLASH_ECC_REGS
ERR_THRESHOLD.ERR_THRESHOLD フィールド) を 1 以上の値に設定します。スレッシュ
ホールド ビット フィールドのデフォルト値は 0 であることに注意してください。

アドバイザリ フラッシュ API: 量産バージョンは、C2000Ware 4.03.00.00 では利用できません

影響を受けるリビジョン 0、A、B、C

詳細 C2000Ware 4.03.00.00 でリリースされたフラッシュ API バージョン 2.00.00.00 は BETA
STATUS です。PRODUCTION STATUS フラッシュ API バージョンは 2.00.01.00 (またはそれ
以降) であり、C2000Ware バージョン 5.00.00.00 (またはそれ以降) で利用できます。

回避方法 量産アプリケーションやフラッシュ プログラミング ソフトウェアには、フラッシュ API バージョン
2.00.01.00 (またはそれ以降) を使用します。

アドバイザー

FPU: FPU から CPU へのレジスタ移動操作の前にする FPU 2p 操作

影響を受けるリビジョン

0、A、B、C

詳細

このアドバイザーは、マルチサイクル (2p) FPU 命令の後に FPU から CPU へのレジスタ転送が行われる場合に適用されます。FPU-to-CPU READ 命令ソースレジスタが 2p 命令宛先と同じである場合、2p 命令が完了する前に、読み出しは FPU レジスタの値となる可能性があります。これは、2p 命令がパイプラインの E3 フェーズ中に結果のデータ転送に依存するために発生します。E3 フェーズでパイプライン ストールが発生した場合、結果は読み取り命令の時間内に転送されません。

このアドバイザーの影響を受ける 2p 命令は、MPYF32、ADDF32、SUBF32、および MACF32 です。FPU レジスタの読み出しの宛先は、CPU レジスタ (ACC、P、T、XAR0 ~ XAR7) で無ければいけません。レジスタの読み出しが FPU-to-FPU レジスタ転送である場合、このアドバイザーは適用されません。

次の例では、2p 命令 MPYF32 は R6H を宛先として使用します。FPU レジスタ READ MOV32 は、同じレジスタ R6H をソースとして使用し、CPU レジスタを宛先として使用します。E3 パイプラインフェーズでストールが発生した場合、MOV32 は MPYF32 命令が完了する前に R6H の値を読み取ります。

問題の例:

```
MPYF32 R6H, R5H, R0H ; 2p FPU instruction that writes to R6H
|| MOV32 *XAR7++, R4H
F32TOUI16R R3H, R4H ; delay slot
ADDF32 R2H, R2H, R0H
|| MOV32 *--SP, R2H ; alignment cycle
MOV32 @XAR3, R6H ; FPU register read of R6H
```

図 3-4 に、パイプラインにストールがない場合の問題のパイプライン図を示します。

Instruction	F1	F2	D1	D2	R1	R2	E	W	Comments
	FPU pipeline-->				R1	R2	E1	E2	
I1 MPYF32 R6H, R5H, R0H MOV32 *XAR7++, R4H	I1								
I2 F32TOUI16R R3H, R4H	I2	I1							
I3 ADDF32 R3H, R2H, R0H MOV32 *--SP, R2H	I3	I2	I1						
I4 MOV32 @XAR3, R6H	I4	I3	I2	I1					
		I4	I3	I2	I1				
			I4	I3	I2	I1			
				I4	I3	I2	I1		
					I4	I3	I2	I1	I4 samples the result as it enters the R2 phase. The product R6H=R5H*R0H (I1) finishes computing in the E3 phase, but is forwarded as an operand to I4. This makes I4 appear to be a 2p instruction, but I4 actually takes 3p cycles to compute.
						I4	I3	I2	
							I4	I3	

図 3-4. パイプラインにストールがない場合の問題のパイプライン図

アドバイザー (続き) **FPU: FPU から CPU へのレジスタ移動操作の前にする FPU 2p 操作**

図 3-5 に、命令 I1 の E3 スロットにストールがある場合の問題のパイプライン図を示します。

	Instruction	F1	F2	D1	D2	R1	R2	E	W	Comments	
		FPU pipeline-->					R1	R2	E1		E2
I1	MPYF32 R6H, R5H, R0H MOV32 *XAR7++, R4H	I1									
I2	F32TOUI16R R3H, R4H	I2	I1								
I3	ADDF32 R3H, R2H, R0H MOV32 *--SP, R2H	I3	I2	I1							
I4	MOV32 @XAR3, R6H	I4	I3	I2	I1						
			I4	I3	I2	I1					
				I4	I3	I2	I1				
					I4	I3	I2	I1			
						I4	I3	I2	I1		
							I4	I3	I2	I1 (STALL)	I4 samples the result as it enters the R2 phase, but I1 is stalled in E3 and is unable to forward the product of R5H*R0H to I4 (R6H does not have the product yet due to a design bug). So, I4 reads the old value of R6H.
							I4	I3	I2	I1	There is no change in the pipeline as it was stalled in the previous cycle. I4 had already sampled the old value of R6H in the previous cycle.
								I4	I3	I2	Stall over

図 3-5. 命令 I1 の E3 スロットにストールがある場合の問題のパイプライン図

回避方法

このシナリオでは、MPYF32、ADDF32、SUBF32、および MACF32 を 3p サイクル命令として扱います。命令のディレイ スロットには、3 つの NOP 命令または矛盾しない命令を配置する必要があります。

C28x コード生成ツール v.6.2.0 以降のバージョンでは、正しい命令シーケンスが生成され、アセンブリコードのエラーが検出されます。以前のバージョンの v6.0.5 (6.0.x 分岐の場合) および v.6.1.2 (6.1.x 分岐の場合) では、コンパイラは正しい命令シーケンスを生成しますが、アセンブラはアセンブリコードのエラーを検出しません。

回避方法の例:

```

MPYF32 R6H, R5H, R0H
|| MOV32 *XAR7++, R4H ; 3p FPU instruction that writes to R6H
F32TOUI16R R3H, R4H ; delay slot
ADDF32 R2H, R2H, R0H
|| MOV32 *--SP, R2H ; delay slot
NOP ; alignment cycle
MOV32 @XAR3, R6H ; FPU register read of R6H

```

図 3-6 に、回避方法が適用されたパイプライン図を示します。

アドバイザリ (続き)

FPU: FPU から CPU へのレジスタ移動操作の前にする FPU 2p 操作

	Instruction	F1	F2	D1	D2	R1	R2	E	W	Comments	
		FPU pipeline-->				R1	R2	E1	E2		E3
I1	MPYF32 R6H, R5H, R0H MOV32 *XAR7++, R4H	I1									
I2	F32TOUI16R R3H, R4H	I2	I1								
I3	ADDF32 R3H, R2H, R0H MOV32 *--SP, R2H	I3	I2	I1							
I4	NOP	I4	I3	I2	I1						
I5	MOV32 @XAR3, R6H	I5	I4	I3	I2	I1					
				I5	I4	I3	I2	I1			
					I5	I4	I3	I2	I1	I1 (STALL)	Due to one extra NOP, I5 does not reach R2 when I1 enters E3; thus, forwarding is not needed.
						I5	I4	I3	I2	I1	There is no change due to the stall in the previous cycle.
							I5	I4	I3	I2	I1 moves out of E3 and I5 moves to R2. R6H has the result of R5H*R0H and is read by I5. There is no need to forward the result in this case.
								I5	I4	I3	

図 3-6. 回避方法が適用されたパイプライン図

アドバイザリ **GPIO19/X1: 推奨動作条件の範囲外で電圧を印加すると、デバイスの誤動作が発生する可能性があります**

影響を受けるリビジョン 0、A、B、C

詳細

GPIO19/X1 ピンに推奨動作条件の範囲外の電圧 (VDDIO より高い電圧、または VSS より低い電圧) が印加された場合、デバイスは正常に動作しない可能性があります。次のような影響があります:

- 電源オンまたは XRSn デアサート後、デバイスはブート ROM を終了しません
- デバイスは JTAG 経由で接続できません
- アプリケーション コード実行中のデバイス クロック周波数に影響します

回避方法

このデバイスの GPIO19/X1 ピンのレイアウトと配線に特に注意してください。このピンの仕様外の電圧が問題の原因ですが、範囲外の電圧を送るソースは、ピンに接続された外付け部品から、または PCB 上の他のソースからのノイズ結合によって発生することがあります。GPIO19 にシングルエンド クロックが印加されている場合、外部クロックドライバのインピーダンスの不一致とこのピンの特性が原因で過電圧が発生することもあります。印加される電圧がデータシートの許容誤差の範囲内であるかどうかを判定するため、シグナル インテグリティを検証することを推奨します。

このピンをシステムで使用しない場合、データシートから未使用のピンに対応する推奨事項が引き続き適用されます:

- 接続なし (入力モードで内部プルアップをイネーブル)
- 接続なし (出力モードで内部プルアップをディセーブル)
- プルアップまたはプルダウン抵抗 (任意の値の抵抗、入力モードで内部プルアップをディセーブル)

ただし、PCB 設計で可能なら、このピンでのノイズの影響を最小限に抑えるため、最後の箇条書き項目を変更することを推奨します:

- このピンを VSS に直接接続します

アドバイザー I2C: ターゲット トランスミッタ モード、標準モードの SDA タイミング制限

影響を受けるリビジョン 0、A、B、C

詳細

MCU に搭載された I2C 周辺装置はファースト モード デバイスであり、スタンダードモードのホストで使用する場合、SCL (クロック) ラインをクロック ストレッチします。

スタンダード モード システムで使用されるファースト モード デバイスについては、I2C 仕様に SCL ラインを解放する前に、 $t_{SU:DAT}$ (データセット アップ時間) + $t_r(max)$ (立ち上がり時間) を満たすという要件があります。NXP セミコンダクタ I²C バス仕様およびユーザー マニュアル (UM10204) の「標準、高速、および高速モード プラス I²C バス デバイスの SDA および SCL バスラインの特性」表の脚注 4 を参照してください。

ただし、C2000 I2C クロックは、上記のシナリオでは、SCL ラインを $6 * f_{mod}$ クロック (C2000 の I2C クロック レート) の固定値だけストレッチします。C2000™ マイクロコントローラがスタンダードモードのホストとともにターゲット トランスミッタとして動作しているとき、SDA の t_r が長すぎると、データ (SDA) の準備が完了する前に、C2000 によってクロックライン (SCL) が解放される可能性があります。

NXP セミコンダクタ I²C バス仕様とユーザー マニュアル (UM10204) の「プルアップ抵抗のサイズ設定」セクションでは、式 1 に示されている立ち上がり時間 (t_r) とバス容量 (C_b) に基づいて、適切な PU 抵抗 (R_p) の選択について詳細に説明しています。

$$R_p(max) = \frac{t_r}{0.8473 \times C_b} \tag{1}$$

回避方法

1. 強力なプルアップで t_r を減らす

$t_{SU:DAT} + t_r(max)$ が満たされることを保証するために、ユーザーは、システムの f_{mod} クロックの値に基づいて、表 3-3 の SDA データ立ち上がり時間要件列にリストされている制約を満たすように SDA ラインのプルアップ抵抗を構成できます。これにより、C2000 が SCL 信号を解放したときに、SDA ラインに存在するデータが有効になることが保証されます。

表 3-4 に、特定の f_{mod} クロック (MHz) および C_b (バス容量) に対して推奨される R_p 抵抗値を示します。 C_b の他の値については、式 1 を使用して、システムに必要な R_p の値を計算してください。

表 3-3. 標準モードホストを備えたターゲット トランスミッタとしての C2000 のデータ立ち上がり時間要件

f_{mod} クロック (MHz)	f_{mod} 期間 (ns)	C2000 I2C からの SCL クロックストレッチ遅延 (ns): ($6 * f_{mod}$ クロック)	データ セットアップ時間 (ns): $t_{SU:DAT}$ (標準モード)	SDA データの立ち上がり時間の要件 (ns): t_r
7	142.9	857	250	607
8	125	750		500
9	111	666		416
10	100	600		350
11	90.9	545		295
12	83.3	500		250

アドバイザー (続き)
I2C: ターゲット トランスミッタ モード、標準モードの SDA タイミング制限
表 3-4. 一般的なバス容量 (C_b) のプルアップ抵抗 (R_p) 値

f_{mod} クロック (MHz)	SDA データの立ち上がり時間の要件 (ns): t_r	R_p (k Ω) $C_b = 100\text{pF}$ の場合	R_p (k Ω) $C_b = 200\text{pF}$ の場合	R_p (k Ω) $C_b = 300\text{pF}$ の場合	R_p (k Ω) $C_b = 400\text{pF}$ の場合
7	607	7.1	3.5	2.3	1.7
8	500	5.9	2.9	1.9	1.4
9	416	4.9	2.4	1.6	1.2
10	350	4.1	2.0	1.3	1.0
11	295	3.4	1.7	1.1	0.8
12	250	2.9	1.4	0.9	0.7

2. $t_r = 1000\text{ns}$

この回避方法は、一般的な I2C の使用上の制限により推奨されません。可能な場合は回避方法 1 を使用してください。

システムで SDA ラインの立ち上がり時間が 1000ns 必要な場合は、C2000 I2C f_{mod} クロックを 4.8MHz に設定して、クロックストレッチ ($6 * f_{mod}$ クロック) によってこの要件を満たすことができます。その結果、 $t_r = (1/4.8\text{MHz}) * 6 = 1000\text{ns}$ となります。この回避方法は、C2000 I2C が I2C バス上のターゲットとなるシステムでのみ有効です。4.8MHz は、 f_{mod} クロックに 7Mhz から 12Mhz へデータシートに必要な範囲外であることに注意してください。 f_{mod} を 4.8Mhz で使用すると、データシートの必要な範囲外であっても、C2000 I2C に対してスタンダードモードのホストバス上でターゲットモードで動作します。この回避方法に記載されているものを除く他の構成で $f_{mod} = 4.8\text{Mhz}$ を使用すると、他のタイミングパラメータに違反し、許可されません。

アドバイザリ **メモリ: 有効なメモリを超えたプリフェッチ**

影響を受けるリビジョン 0、A、B、C

詳細

C28x CPU は、パイプラインで現在アクティブな命令を超える命令をプリフェッチします。プリフェッチが有効なメモリの終了後に発生した場合、CPU は無効なオPCODEを受信する可能性があります。

回避方法

M1 – プリフェッチ キューは 8×16 ワードの深さです。したがって、コードは 有効なメモリの終わりから 8 ワード以内にはなりません。2 つの有効なメモリ ブロック間の境界を越えてプリフェッチすることは問題ありません。

事例 1: M1 はアドレス 0x7FF で終了し、その後に別のメモリ ブロックが続くことはありません。M1 のコードは、アドレス 0x7F7 以下に格納されないようにする必要があります。アドレス 0x7F8 ~ 0x7FF はコードには使用できません。

事例 2: M0 はアドレス 0x3FF で終了し、有効なメモ (M1) がその後に続きます。M0 のコードは、アドレス 0x3FF まで保存できます。コードはアドレス 0x7F7 までの M1 にクロスすることもできます。

表 3-5. アドバイザリによって影響を受けるメモリ

メモリタイプ	影響を受けるアドレス
M1	0x0000 07F8–0x0000 07FF

アドバイザー **MPOST:一部の初期素材ではメモリ パワーオン セルフテストが実行されません**

影響を受けるリビジョン 0, A, B, C

詳細

MPOST (メモリ パワーオン セルフテスト) は、機能安全アプリケーションで使用して、電源投入時にデバイスのメモリをテストすることができます。この機能は、DCSM セキュリティツールを使用して Z1_GPREG2.MPOST ビットへ書き込むことでアクティブになります。影響を受ける素材は、Z1_GPREG2.MPOST ビットに書き込んでも、MPOST は実行されません。

回避方法

- **OTP リビジョンの確認:** 固定素材の OTP リビジョン番号は 2 より大きくなります。OTP リビジョン番号は、表 3-6 を使用して求めることができます。MPOST は、『[TMS320F280013x リアルタイム マイコン テクニカル リファレンス マニュアル](#)』に記載されているとおりに動作します。
- **F280013x SDL での等価性メモリーテスト:** F280013x ソフトウェア診断ライブラリ (SDL) の一部として含まれている STA_MARCH 関数を使用すると、メイン アプリケーションから実行できるメモリの等価性テストになります。SDL は次の親ディレクトリの C2000Ware インストールに含まれています: `C:/ti/c2000/C2000Ware_5_02_00_00/libraries/diagnostic/f280013x/`。このメモリ チェックの実行方法については、「examples」フォルダの「test application」プロジェクトと、「docs」サブフォルダの STL の説明を参照してください。

表 3-6. OTP リビジョン番号の位置

アドレス	8 ビット MSB	8 ビット LSB
0x0007 11DE	0x5A	OTP のリビジョン

アドバイザリ システム: **CLKSRCCTL1** への複数の連続した書き込みを行うと、システムがハングする可能性があります

影響を受けるリビジョン 0、A、B、C

詳細

書き込み間に遅延なしで **CLKSRCCTL1** レジスタに複数回書き込むと、システムがハングアップし、外部 **XRSn** リセットまたはウォッチドッグリセットでのみ回復できます。この条件の発生は、**SYSCLK** と **OSCCLKSRCSEL** で選択したクロックとの間のクロック比によって異なり、毎回発生するとは限りません。

デバッガの使用中にこの問題が発生した場合、一時停止すると、プログラムカウンタはブート ROM リセット ベクタになります。

回避方法を実装すると、**SYSCLK/OSCCLK** の比率でこの条件を回避できます。

回避方法

CLKSRCCTL1 レジスタへの書き込みごとに、**NOP** 命令を使用して、**300 SYSCLK** サイクルのソフトウェア遅延を追加します。

例:

```

ClkCfgRegs.CLKSRCTL1.bit.INTOSC2OFF=0;           // Turn on INTOSC2
asm(" RPT #250 || NOP");                          // Delay of 250 SYSCLK cycles
asm(" RPT #50 || NOP");                           // Delay of 50 SYSCLK cycles
ClkCfgRegs.CLKSRCTL1.bit.OSCCLKSRCSEL = 0;        // Clk Src = INTOSC2
asm(" RPT #250 || NOP");                          // Delay of 250 SYSCLK cycles
asm(" RPT #50 || NOP");                           // Delay of 50 SYSCLK cycles
  
```

C2000Ware_3_00_00_00 以降のリビジョンでこの回避策が実装されます。

アドバイザリ PLL リファレンス クロック消失検出: クロック消失フラグが正しくアクティブ化されない可能性があります

影響を受けるリビジョン 0、A、B、C

詳細 レジスタ ビット `SYSPLLSTS.REF_LOSTS` の設定が誤っており、リファレンス クロックの損失を示す可能性があります。

回避方法 PLL リファレンス クロック消失検出機能は使用しないでください。代わりに、欠落クロック検出 (MCD) 機能またはデュアル クロック コンパレータ (DCC) を使用して、リファレンス クロックの損失を検出します。

- MCD 方式については、`sysctl` フォルダにある C2000Ware サンプルの `sysctl_ex1_missing_clock_detection` を参照してください。
- DCC 方式については、`dcc` フォルダにある C2000Ware サンプルの `dcc_ex4_clock_fail_detect` を参照してください。

アドバイザリ ウォッチドッグ:WDKEY レジスタは **EALLOW** 保護されていません

影響を受けるリビジョン 0、A、B、C

詳細 WDKEY レジスタは **EALLOW** 保護されていません。このレジスタに書き込むために **EALLOW** および **EDIS** 命令を発行する必要はありません。WDKEY が **EALLOW** 保護されている他のデバイスでソフトウェアの再利用をイネーブルにするには、**EALLOW** および **EDIS** を推奨します。

回避方法 なし

4 シリコン リビジョン B の使用上の注意とアドバイザリ

このセクションには、このシリコン リビジョンの使用上の注意およびアドバイザリが記載されています。

4.1 シリコン リビジョン B の使用上の注記

シリコン リビジョンに適用される使用上の注意が、新しいシリコン リビジョンで見つかりました。詳細については、[シリコン リビジョン C の使用上の注意](#)を参照してください。

4.2 シリコン リビジョン B のアドバイザリ

シリコン リビジョンに適用されるアドバイザリが、新しいシリコン リビジョンで見つかりました。詳細については、[シリコン リビジョン C のアドバイザリ](#)を参照してください。

5 シリコン リビジョン A の使用上の注意とアドバイザリ

このセクションには、このシリコン リビジョンの使用上の注意およびアドバイザリが記載されています。

5.1 シリコン リビジョン A の使用上の注記

シリコン リビジョンに適用される使用上の注意が、新しいシリコン リビジョンで見つかりました。詳細については、[シリコン リビジョン C の使用上の注意](#)を参照してください。

5.2 シリコン リビジョン A のアドバイザリ

シリコン リビジョンに適用されるアドバイザリが、新しいシリコン リビジョンで見つかりました。詳細については、[シリコン リビジョン C のアドバイザリ](#)を参照してください。

6 シリコン リビジョン 0 の使用上の注意とアドバイザリ

このセクションには、このシリコン リビジョンの使用上の注意およびアドバイザリが記載されています。

6.1 シリコン リビジョン 0 の使用上の注記

シリコン リビジョンに適用される使用上の注意が、新しいシリコン リビジョンで見つかりました。詳細については、[シリコン リビジョン C の使用上の注意](#)を参照してください。

6.2 シリコン リビジョン 0 のアドバイザリ

シリコン リビジョンに適用されるアドバイザリが、新しいシリコン リビジョンで見つかりました。詳細については、[シリコン リビジョン C のアドバイザリ](#)を参照してください。

7 ドキュメントのサポート

デバイス固有のデータシートおよび関連ドキュメントについては、TI の Web サイト <https://www.ti.com> をご覧ください。

TMS320F280013x デバイスの詳細については、以下のドキュメントを参照してください。

- 『[TMS320F280013x リアルタイム マイクロコントローラ](#)』データシート
- 『[TMS320F280013x リアルタイム マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル](#)』

8 商標

C2000™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

9 改訂履歴

Changes from DECEMBER 10, 2024 to JULY 28, 2025	Page
• この改訂履歴には、 SPRZ506D から SPRZ506E への変更点が記載されています。.....	3
• 繰り返しブロックでネストされた割り込みを使用する際の注意 使用上の注意: タイトルを「 ネストされた割り込みを使用する際の注意 」から「 繰り返しブロックでネストされた割り込みを使用する際の注意 」に変更しました。使用上の注意を更新しました。.....	7

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適したテキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されているテキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかるテキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated